



2026年1月6日

各 位

キャリア付極薄銅箔で高温対応「MicroThin™」の技術開発を完了 ～ 高温プロセス基板にも展開可能に ～

当社（社長 納武士）は「MicroThin™」に関して、2025年11月11日付ニュースリリース「キャリア付極薄銅箔「MicroThin™」フレキシブル基板用途に展開」に記載しておりました、高温プロセスでも剥離可能な「MicroThin™」の技術開発が完了しましたことをお知らせいたします。

当社のキャリア付極薄銅箔「MicroThin™」は、微細回路形成に適した $1.5 \mu\text{m} \sim 5 \mu\text{m}$ の銅箔厚みと複数種類の微細な粗化処理を組み合わせた製品であり、従来より主に半導体パッケージ基板、スマートフォン用マザーボード（HDIプリント基板）に使用されており、近年では新たにフレキシブル基板にも採用が進んでおります。

今回技術開発した高温対応「MicroThin™」は、 350°C 以上でも安定して剥離可能な耐熱剥離層を有しており、高温プロセスが必要な MPI^{*1}、LCP^{*2}、PTFE^{*3}などの誘電特性に優れた基板にも適用が可能となります。次世代モバイルデバイスなどに用いられる高い電気特性が求められる基板に対しても、微細回路形成や薄型化、信頼性向上を実現できる材料として採用が進むことが期待されます。

当社は、パーソンズである「探索精神と多様な技術の融合で、地球を笑顔にする。」を基軸に、2030年のありたい姿である全社ビジョン「マテリアルの知恵で “未来” に貢献する、事業創発カンパニー。」を実現することで、サステナブル（持続可能）な社会作りに貢献します。

以 上

*1 … MPI (Modified Polyimide)、変性ポリイミド

*2 … LCP (Liquid Crystal Polymer)、液晶ポリマー

*3 … PTFE (Polytetrafluoroethylene)、ポリテトラフルオロエチレン

※一般に比誘電率は、MPI > LCP > PTFE。低いほど伝送損失が小さくなる

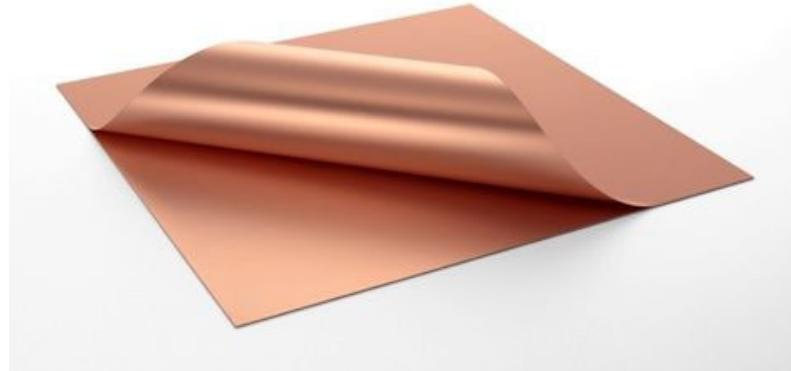
【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL : 03-5437-8028

E メール : PR@mitsui-kinzoku.com

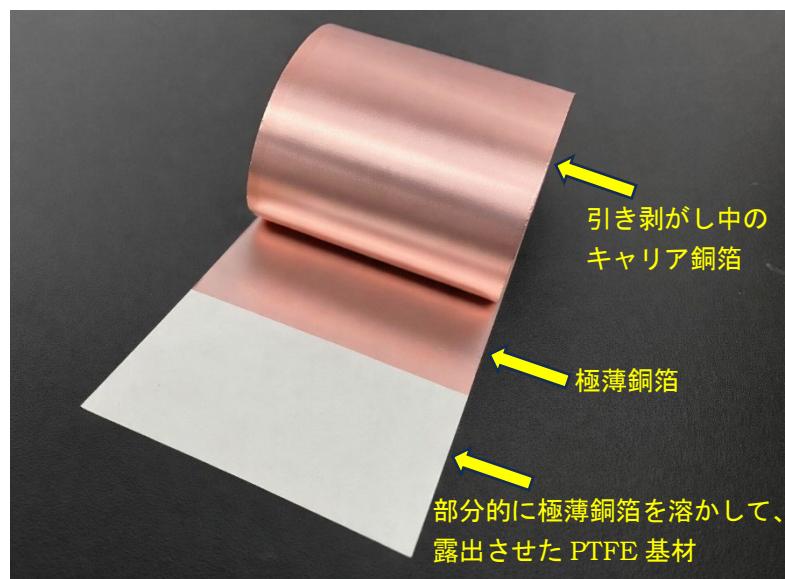
「MicroThinTM」写真



上部：キャリア銅箔（厚み 18μm、12μm）

下部：極薄銅箔（厚み 1.5μm～5μm）

今回技術開発した高温対応「MicroThinTM」写真
(PTFE 基材に高温でプレス積層したもの)



上部：キャリア銅箔（厚み 18μm、12μm）

中部：極薄銅箔（厚み 1.5μm～5μm）

下部：PTFE基材(白色部)